

Raffreddamento a liquido per le prossime CPU Intel Sandy Bridge E ?



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/3557/raffreddamento-a-liquido-per-le-prossime-cpu-intel-sandy-bridge-e-.htm>)

Intel studia nuove soluzioni di raffreddamento per le future CPU di fascia alta dedicate al mercato Enthusiast.

Intel Corp. pare stia pensando di offrire in bundle con la sua prossima generazione di CPU, nome in codice Sandy Bridge E (SNB-E), una soluzione di raffreddamento a liquido di tipo compatto.

Tale soluzione permetterà ai microprocessori Intel Extreme Edition (XE) di lavorare a frequenze ancora più elevate e quindi offrire maggiori prestazioni complessive.

Per molti anni Intel ha utilizzato sui suoi chip boxed soluzioni di raffreddamento piuttosto semplici ma, di recente, la società ha iniziato ad offrire dispositivi di raffreddamento più performanti dotati di heatpipes, almeno sulle CPU di fascia alta con socket LGA1366.

All'Intel Developer Forum di Pechino, in Cina, gli ingegneri di Intel hanno presentato un documento chiamato "Overclocking Intel Processor Based Desktop and Mobile Platforms", dove si è discusso del passato, presente e futuro supporto della società al fenomeno dell'overclocking.

Tra le altre cose, il documento afferma che "per la generazione SNB-E di CPU boxed si sta considerando l'idea di adottare un sistema di dissipazione a liquido".

Sarà la prima volta che Intel supporterà ufficialmente una soluzione di questo tipo, e il produttore conta che questa scelta possa indiscutibilmente far aumentare la popolarità delle sue CPU di fascia alta.

Su una diapositiva proiettata durante l'evento viene mostrato un sistema di raffreddamento liquido Corsair H50, ma nel bundle Intel potrebbe esserci anche una soluzione diversa.

Al momento infatti ci sono solo due società che potrebbero collaborare con Intel per una soluzione del genere: Asetek e CoolIT.

↔

Intel Channel Thermal Solutions

- Client Platform Engineering and Channel DBX-B held 10% improved performance over reference design. Theta CA = .21 C/W
- Meets existing acoustic targets with Quiet Mode. Performance Mode available for overclocking
- Heat pipe technology within the existing LGA1366 XE and LGA1156 thermal mechanical design guides
- Robust structural solution enables shipping assembled in a chassis.

- SNB-E generation considering boxed liquid cooling



Intel invests in new enthusiast thermal technologies!

IDF2011
INTEL DEVELOPER FORUM

↔

La prima al momento collabora con Corsair per la progettazione e realizzazione degli attuali sistemi di raffreddamento della serie Hydro e con Antec per i modelli della serie K&aelar H2O, mentre CoolIT Systems ha recentemente annunciato la cooperazione con Corsair sulle soluzioni future.

I microprocessori Intel Sandy Bridge E arriveranno nel 4° trimestre 2011 e sono specificatamente progettati per gli appassionati che esigono il massimo delle prestazioni.

Il chip avrà in dotazione una "cache extra large" per massimizzare la velocità delle applicazioni a singolo e doppio thread, il controller di memoria sarà quad-channel e sarà dotato di quattro o sei core che sfrutteranno la tecnologia Patsburg core-logic.

Le nuove piattaforme saranno caratterizzate da un generatore di clock esterno che permetterà di aumentare la frequenza dei microprocessori con metodi tradizionali, aumentando la frequenza DMI, senza interferire con gli altri bus di sistema (USB, SATA), garantendo quindi un overclock più facile ed efficiente. Grazie ad una serie di miglioramenti della micro-architettura di Sandy Bridge, la nuova linea di processori Intel Extreme promette di essere molto veloce, resta da vedere se l'esa-core di Intel sarà in grado di sovraperformare i chip a otto core di Advanced Micro Devices, che sono attesi nel Q2 - Q3 2011.

↔

↔